

符 號 說 明

- V_{PI} : 突衝電壓。
- σ_{Th} : 熱應力。
- E_y : 欲鍍薄膜材料的楊氏係數。
- Δt : 製程溫度和室溫之間的溫度差。
- α_{film} : 欲鍍薄膜材料的熱膨脹係數。
- α_{sub} : 晶片的熱膨脹係數。
- θ : 微懸臂樑轉動角。
- V_{PI} : 極限電壓值。
- Q : 通入的電量。
- F : 法拉第常數，每莫耳電子所攜帶的電量(96487 庫侖/莫耳)。
- ΔW : 電解物質的質量變化。
- M : 物質的原子量。
- n : 接受(或失去)的電子數。
- E : 測試樣本的楊氏係數。
- A : 微壓痕器 P_{max} 時的壓痕表面積。
- dP : 微壓痕器移除壓力(Unloading)時壓力的變化量。
- dh : 微壓痕器移除壓力時壓痕接觸深度的變化量。
- H : 測試樣本的硬度。
- P_{max} : 微壓痕器最大施加壓力。
- f : 為一常數(視壓痕器種類而定)。
- h_c : P_{max} 時的接觸深度。
- α : 為熱膨脹係數。
- T : 試片初始測試溫度。
- L : 溫度為 T 時，所量得的微懸臂樑長度。
- T' : 試片溫度上昇後測試溫度。
- L' : 溫度為 T' 時，所量得的微懸臂樑長度。
- ΔT : 溫度變化量。
- ΔL : 長度變化量。
- $d\sigma$: 熱應力變化量。
- dT : 溫度變化量。